

**新型コロナウイルス感染症対策として在宅勤務を推進する製造業のお客様へ
「FUJITSU Manufacturing Industry Solution COLMINA CAE 設計者向け構造解析」
無償提供のご案内**

更新日:2020年8月19日

掲載日:2020年5月25日

富士通株式会社

富士通株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:時田 隆仁、以下、富士通)は、新型コロナウイルス感染症対策として在宅勤務を推進する製造業のお客様へ、機械・装置設計分野の解析業務が可能な構造解析ソフトウェア「FUJITSU Manufacturing Industry Solution COLMINA CAE 設計者向け構造解析」を無償で提供させていただきます。

記

対象サービス

「FUJITSU Manufacturing Industry Solution COLMINA CAE 設計者向け構造解析」
(旧名称:FJKSWAD)

強度解析、振動解析、熱解析に対応した設計者向けの構造解析ソフトウェアです。

設計の早い段階から、設計者自身が製品の強度・振動・熱に関する性能評価を行うことができ、「品質向上」「期間短縮」「コスト削減」といった、ものづくり現場の問題解決に大きく貢献します。

<https://www.fujitsu.com/jp/solutions/business-technology/tc/sol/fjkswad/>

対象となる方

在宅勤務を推進する製造業のお客様(日本国内の法人)

※日本国内でのご利用に限定させていただきます。

無償提供期間

2020年5月25日(月)から2020年9月30日(水)まで

※新型コロナウイルスの状況を鑑み、2020年8月末から9月末まで期間を延長いたします。

お申込み手続き

以下にお問い合わせください。

富士通株式会社 PLMソリューション事業部

COLMINA CAE 設計者向け構造解析(FJKSWAD)担当

Tel:026-237-7029

E-mail:contact-fjkswad@cs.jp.fujitsu.com

新型コロナウイルス感染症の1日も早い終息を心よりお祈り申し上げます。

以上